

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 5 月 2 日 (02.05.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/34467 A1

(51) 国際特許分類: B24B 37/00, 53/02, H01L 21/304

(21) 国際出願番号: PCT/JP01/00382

(22) 国際出願日: 2001 年 1 月 22 日 (22.01.2001)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2000-324290
2000 年 10 月 24 日 (24.10.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都大田区羽田旭町11番1号 Tokyo (JP).

相澤英夫 (AIZAWA, Hideo) [JP/JP]. 赤木 真 (AKAGI, Makoto) [JP/JP]. 徳重克彦 (TOKUSHIGE, Katsuhiko) [JP/JP]. 松尾尚典 (MATSUO, Hisanori) [JP/JP]. 辻村 学 (TSUJIMURA, Manabu) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社 荏原製作所内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 渡邊 勇, 外 (WATANABE, Isamu et al.); 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目5番8号 GOWA 西新宿4階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): KR, SG, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

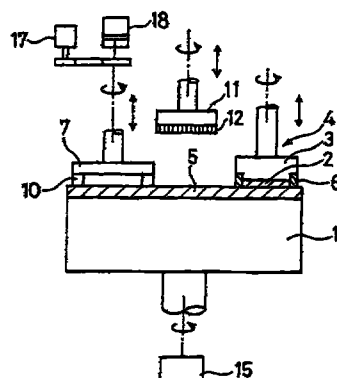
(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 上村 健司 (KAMIMURA, Kenji) [JP/JP]. 木村 憲雄 (KIMURA, Norio) [JP/JP]. 岡村 聡 (OKAMURA, Satoshi) [JP/JP].

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLISHER

(54) 発明の名称: ポリッシング装置



(57) Abstract: The invention relates to a polisher for polishing a workpiece, such as a semiconductor wafer, so that it may have a flat mirror finish. The polisher comprises a polisher table (1) with a polishing face, and a top ring (3). A workpiece is placed between the polisher table (1) and the top ring (3) and polished by application of a predetermined pressure. The polisher includes at least two dressing units equipped with dressers (7, 11) that are in contact with the surface of polishing cloth to dress the polishing face.

WO 02/34467 A1

[続葉有]



(57) 要約:

本発明は、半導体ウエハなどの研磨対象物を平坦かつ鏡面状に研磨するポリッシング装置に関するものである。ポリッシング装置は、研磨面を有する研磨テーブル（１）とトップリング（３）とを有し、前記研磨テーブル（１）とトップリング（３）との間に研磨対象物を介在させて、所定の圧力で押圧することによって研磨対象物を研磨する。ポリッシング装置は、研磨布の表面に接触して前記研磨面のドレッシングを行なうドレッサー（７）、（１１）を備えた少なくとも２個のドレッシングユニットを備える。